

目錄

2011年9月號 · No. 194

IC製程技術專輯

IC Process Technology

企業專訪

- 12** 創新的氟素樹脂管件
與接頭專利連接技術
專訪和正豐科技股份有限公司
流體控制事業部協理－陳柏文 先生

市場 | 觀察 | 分析

- 71** 廠商熱訊
- 87** 通訊晶片商機 產品完整爭優勢
日電視釋單 可帶動面板需求
- 88** 康寧：下半年顯示器零售市場疲
太陽能成本降 美安裝率大增
- 89** 半導體旺季不旺 法說受矚目
聯電賽普拉斯合作65奈米技術
- 90** 德儀Q3財測低於部分市場預估

IC製程技術專輯－林鴻志 主編

- 92** IC製程技術專輯前言
林鴻志
- 94** 原子層沉積技術與應用
蘇俊榮
- 104** 三維積體電路技術
張耀仁、陳冠能
- 122** 深反應性離子蝕刻技術
與三維積體電路
彭俊翔
- 136** 高壓IC元件與製程
陳柏安、潘欽寒、賴明芳

CONTENTS



專 題

主被動元件

- 156** 無鉛壓電陶瓷材料與元件之技術與發展
楊茹媛、黃雅莉、潘正堂、翁敏航

3D IC

- 172** 三維積體電路/矽整合的直通矽穿孔(TSV)
之進化、挑戰和展望
文/劉漢誠·譯/吳偉琳、吳昇財

量測技術與設備

- 206** 探討X光光電子能譜儀分析系統組件技術
用於二氧化鈦化學態鍵結與計量分析
楊君惠

PCB技術小百科

- 216** 高密度連線(HDI)微通孔製程(二)
編輯部

人生偶拾

- 218** 你想成為一個預言家嗎?
黃博治

本刊圖文非經同意，不得轉載或傳送！

社內消息

廣告部

- 53 廣告索引

發行部

- 91 叢書系列
121 日本JIS手冊訂閱消息
171 日經BP社雜誌訂閱消息
215 國際專業期刊訂閱消息
221 劃撥單

編輯部

- 54 意見調查表
135 2011年10月電子測試專輯預告
220 投稿須知